

DIAGNÓSTICO Y REBALLING APLICADO EN ANDROID

Básico / Intermedio

Por

Anthony Ramírez



Sesión 1

- Componentes básicos.
- Circuitos integrados.
- Simbología en un esquemático.
- Nomenclaturas.
- Interpretación de líneas en un diagrama.
- Uso de plataformas de diagramas.
- Manuales de servicio.
- Herramientas básicas de medición.
- Fuente de alimentación.
- Uso de multímetro.
- Conceptos básicos
- Escala de diodos y caída de tensión
- Anotaciones especiales en componentes básicos

Sesión 2

- Protocolo de inspección y búsqueda de fallas.
- Diagnóstico inicial de fallas.
- Tipos de cortos.
- Corto total.
- Corto línea segunda etapa.
- Corto línea tercera etapa.
- Sectorización de componentes en una tarjeta.
- Agrupación de diferentes circuitos.
- Retiro de blindajes para inspección.

Sesión 3

- Falla de imagen.
- Falla de carga (carga falsa, carga lenta, señales térmicas circuitos de protección).
- Interpretación de consumos en USB.
- Fallas de touch.
- Fallas de wifi (no activación, no cobertura).
- Problemas de radiofrecuencia (no señal, señal baja, no IMEI).
- Fallas de audio (codec, amplificadores).
- Problemas de arranque en CPU y memoria.
- Prácticas.

Sesión 4

- Extracción de componentes y Reballing de circuitos integrados.
- Trabajo con temperaturas y aire para reballing.
- Extracción y recuperación e Instalación de conectores FPC.
- Recuperación de pistas dañadas por corrosión, arrancadas y quemadas.
- Extracción y Reballing de circuitos integrados.
- Limpieza.
- Montaje y temperaturas, tamaños de boquillas y sus usos ajustando estación de calor.
- Prácticas.

Sesión 5

- Consumos en fuente de alimentación así como su interpretación y sospecha de fallas.
- Prácticas de colegas Solución a equipos y estudio a sus propios equipos.
- Prácticas de extracción.
- Resumen rápido de temas pendientes.